

# 天水华天科技股份有限公司

## 2014年度财务决算报告

### 一、2014 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2014 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2015]第 62020013 号的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天水华天科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 2、主要财务数据和指标：

单位：万元

| 项 目                  | 2014 年     | 2013年      | 同比增长 (%) |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 1、营业收入               | 330,548.17 | 244,716.33 | 35.07    |
| 2、利润总额               | 34,824.66  | 22,656.25  | 53.71    |
| 3、归属于母公司所有者的净利润      | 29,818.31  | 19,916.43  | 49.72    |
| 4、资产总额               | 415,805.18 | 355,900.97 | 16.83    |
| 5、归属于母公司所有者权益        | 240,725.41 | 177,568.57 | 35.57    |
| 6、每股净资产（元）           | 3.4536     | 2.7326     | 26.39    |
| 7、每股收益（元）            | 0.4483     | 0.3065     | 46.26    |
| 8、加权平均净资产收益率（%）      | 14.72      | 12.20      | 2.52     |
| 9、每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.7936     | 0.5966     | 33.02    |

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产情况：

单位：万元

| 项目       | 2014年      | 2013年      | 增长额       | 同比增长 (%) |
|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 资产总额     | 415,805.18 | 355,900.97 | 59,904.21 | 16.83    |
| 应收票据     | 19,201.14  | 10,969.91  | 8,231.23  | 75.03    |
| 预付款项     | 17,862.36  | 12,767.40  | 5,094.96  | 39.91    |
| 应收利息     | 8.48       | 142.63     | -134.15   | -94.05   |
| 其他应收款    | 1,734.43   | 687.67     | 1,046.76  | 152.22   |
| 可供出售金融资产 | 3,529.98   | 2,100.00   | 1,429.98  | 68.09    |
| 长期股权投资   | 43.95      | 1,701.44   | -1,657.49 | -97.42   |
| 在建工程     | 36,999.76  | 21,686.10  | 15,313.66 | 70.62    |

| 项目     | 2014年 | 2013年 | 增长额    | 同比增长(%) |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| 长期待摊费用 | 58.09 | 98.91 | -40.82 | -41.27  |

2014 年公司总资产增长 16.83%, 具体情况如下:

(1) 应收票据较上期末增长 75.03%, 主要为本报告期销售回款中银行承兑汇票的占比增加, 尚未背书转让的银行承兑汇票较年初增加。

(2) 预付款项较上期末增长 39.91%, 主要为本报告期实施《通讯与多媒体集成电路封装测试产业化》项目, 预付的设备款、工程款增加。

(3) 应收利息较上期末下降 94.05%, 主要为上期募集资金的定期存款本期全部到期解付。

(4) 其他应收款较上期末增长 152.22%, 主要为本报告期支付境外收购 FlipChip International, LLC 公司及其子公司 100%股权的收购保证金 220 美元所致。

(5) 可供出售金融资产较上期末增长 68.09%, 主要为本报告期对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的投资不再具有重大影响, 执行新的《企业会计准则》, 调整至可供出售金融资产。

(6) 长期股权投资较上期末下降 97.42%, 主要为本报告期对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的投资不再具有重大影响, 执行新的《企业会计准则》, 将此部分长期股权投资调整至可供出售金融资产。

(7) 在建工程较上期末增长 70.62%, 主要为本报告期实施的 8#厂房等基础设施建设投资增加。

(8) 长期待摊费用较上期末下降 41.27%, 主要为本报告期摊销租入厂房的改造费用。

## 2、负债情况:

单位: 万元

| 项目                     | 2014 年     | 2013 年     | 增长额       | 同比增长(%)  |
|------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 负债总额                   | 163,318.31 | 158,602.43 | 4,715.88  | 2.97     |
| 短期借款                   | 29,220.70  | 5,133.92   | 24,086.78 | 469.17   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00       | 6,996.90   | -6,996.90 | -100.00  |
| 应付票据                   | 1,425.02   | 46.42      | 1,378.60  | 2,969.53 |
| 应交税费                   | -3,254.29  | -6,319.01  | -3,064.72 | -48.50   |
| 应付利息                   | 64.35      | 186.19     | -121.84   | -65.44   |
| 其他应付款                  | 17,147.62  | 6,158.46   | 10,989.16 | 178.44   |

| 项目          | 2014 年    | 2013 年    | 增长额        | 同比增长(%) |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 一年内到期的非流动负债 | 21,993.86 | 11,615.39 | 10,378.47  | 89.35   |
| 长期借款        | 15,698.88 | 31,920.27 | -16,221.39 | -50.82  |
| 应付债券        | 0.00      | 35,627.28 | -35,627.28 | -100.00 |
| 递延收益        | 19,176.62 | 14,580.33 | 4,596.29   | 31.52   |
| 递延所得税负债     | 190.69    | 1,811.03  | -1,620.34  | -89.47  |

2014 年公司总负债增长 2.97%，具体情况如下：

（1）短期借款较上期末增长 469.17%，主要为本报告期生产经营需要，增加银行短期借款。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上期末下降 100.00%，主要为本报告期公司签订的《贵金属远期买卖交易》合同、《黄金租赁交易合同》在本期全部到期解除。

（3）应付票据较上期末增长 2,969.53%，主要为本报告期新开具的银行承兑汇票增加。

（4）应交税费较上期末下降 48.05%，主要为本报告期尚未抵扣的增值税进项税额较年初减少。

（5）应付利息较上期末下降 65.44%，主要为本报告期可转债转股和赎回导致年末未支付利息减少。

（6）其他应付款较上期末增长 178.44%，主要为本报告期收购华天科技（昆山）电子有限公司少数股东 16.15%股权，截止年末该股权收购款项尚未支付。

（7）一年内到期的非流动负债较上期末增长 89.35%，主要为年末一年内到期的长期借款较年初增加。

（8）长期借款较上期末下降 50.82%，主要为本报告期末将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债中。

（9）应付债券较上期末下降 100.00%，为上年发行的可转债于本期已全部转股或赎回所致。

（10）递延收益较上期末增长 31.52%，为本期收到政府补助项目未验收或费用未发生，尚未进行摊销。

（11）递延所得税负债较上期末下降 89.47%，主要为上年发行的可转债形成的利息调整应纳税暂时性差异，本期可转债全部转股和赎回导致应纳税暂时性差异消除所致。

### 3、股东权益情况：

单位：万元

| 项目     | 期初数       | 本期增加      | 本期减少     | 期末数       |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 股本     | 64,980.80 | 4,722.67  |          | 69,703.47 |
| 资本公积   | 36,988.90 | 31,927.96 |          | 68,916.86 |
| 盈余公积   | 8,296.74  | 2,040.25  |          | 10,336.99 |
| 未分配利润  | 67,302.13 | 29,818.31 | 5,352.35 | 91,768.09 |
| 少数股东权益 | 19,729.97 |           | 7,968.51 | 11,761.46 |

(1) 股本增加 4,722.67 万元，为本报告期“华天转债”进入转股期，累计转股 4,722.67 万股。

(2) 资本公积增加 31,927.96 万元，为本报告期可转债在本期转股所致。

(3) 本期盈余公积增加 2,040.25 万元，为提取的法定盈余公积。

(4) 本期未分配利润增加 29,818.31 万元，为公司当年实现的净利润；未分配利润本期减少 5,352.35 万元，为提取的法定盈余公积 2,040.25 万元和为股东支付的普通股股利 3,312.09 万元。

(5) 期末少数股东权益减少 7,968.51 万元，主要为本报告期购买华天科技（昆山）电子有限公司少数股东 16.15%股权，导致少数股东权益减少。

### 4、经营情况：

2014 年公司集成电路封装量为 106.96 亿只，11.72 万片，同比上期分别增长 27.79%、208.58%，实现营业收入 33.05 亿元，较上期增长 35.07%，利润总额和净利润较上期分别增长 53.71%和 52.37%，主要为报告期内，随《通讯与多媒体集成电路封装测试产业化》项目和《40 纳米集成电路先进封装测试产业化》项目的顺利实施，公司集成电路封装能力稳步提高，项目产能不断释放，公司集成电路封装量和销售量稳步增长，以及华天科技（昆山）电子有限公司全年纳入合并范围。

单位：万元

| 项目      | 2014 年     | 2013 年     | 增长额       | 同比增长(%) |
|---------|------------|------------|-----------|---------|
| 营业收入    | 330,548.17 | 244,716.33 | 85,831.84 | 35.07   |
| 营业成本    | 258,194.70 | 192,018.90 | 66,175.80 | 34.46   |
| 营业税金及附加 | 1,481.47   | 542.20     | 939.27    | 173.23  |
| 管理费用    | 35,211.87  | 24,179.13  | 11,032.74 | 45.63   |
| 资产减值损失  | 246.01     | 703.32     | -457.31   | -65.02  |

| 项目            | 2014 年     | 2013 年     | 增长额       | 同比增长 (%) |
|---------------|------------|------------|-----------|----------|
| 营业收入          | 330,548.17 | 244,716.33 | 85,831.84 | 35.07    |
| 营业成本          | 258,194.70 | 192,018.90 | 66,175.80 | 34.46    |
| 营业税金及附加       | 1,481.47   | 542.20     | 939.27    | 173.23   |
| 管理费用          | 35,211.87  | 24,179.13  | 11,032.74 | 45.63    |
| 资产减值损失        | 246.01     | 703.32     | -457.31   | -65.02   |
| 投资收益          | -154.05    | -1,325.81  | 1,171.76  | -88.38   |
| 营业外收入         | 6,615.45   | 3,771.71   | 2,843.74  | 75.40    |
| 营业外支出         | 8.66       | 47.49      | -38.83    | -81.77   |
| 所得税费用         | 4,246.91   | 2,588.21   | 1,658.70  | 64.09    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,818.31  | 19,916.43  | 9,901.88  | 49.72    |
| 少数股东损益        | 759.44     | 151.62     | 607.82    | 400.91   |

(1) 营业收入较上年同期增长 35.07%，主要为本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率提高，销售额较上年增加；且本期较上年多合并华天科技（昆山）电子有限公司 8 个月的收入。

(2) 营业成本较上年同期增长 34.46%，主要为本报告期营业收入大幅增长。

(3) 营业税金及附加较上年同期增长 173.23%，主要为本报告期销售额较上年增加，进料加工业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加增加。

(4) 管理费用较上年同期增长 45.63%，主要为本报告期研究开发费用与职工薪酬较上年增加。

(5) 资产减值损失较上年同期下降 65.02%，主要为本报告期加强应收账款管理，应收款项的坏账准备计提较上年减少。

(6) 投资收益较上年同期下降 88.38%，主要为上年度通过多次交易，多步实现对华天科技（昆山）电子有限公司的非同一控制下企业合并确认的投资收益较大所致。

(7) 营业外收入较上年同期增长 75.40%，主要为本报告期确认的政府补助较上年同期增加。

(8) 营业外支出较上年同期下降 81.77%，主要为本报告期对外捐赠较上年减少。

(9) 所得税费用较上年同期增长 64.09%，为本期利润总额较上年同期增加。

(10) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 49.72%，为本期净利润较上年同期增加。

(11) 少数股东损益较上年同期增长 400.91%，主要为本为本期净利润较上年同期增加。

## 5、现金流量分析

单位：万元

| 项目             | 2014 年     | 2013 年     | 增长额        | 同比增长(%) |
|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 一、经营活动产生的净现金流量 | 55,314.59  | 38,765.75  | 16,548.84  | 42.69   |
| 二、投资活动产生的净现金流量 | -46,033.15 | -80,318.44 | 34,285.29  | -42.69  |
| 三、筹资活动产生的净现金流量 | 3,747.54   | 41,111.08  | -37,363.54 | -90.88  |

(1) 经营活动产生的净现金流量同比增长 42.69%，主要是公司营业收入增长和回款增加。

(2) 投资活动产生的净现金流量同比下降42.69%，主要是本报告期收回了上期存出的定期存单，和为上年受让华天科技（昆山）电子有限公司股权而支付的现金所致。

(3) 筹资活动产生的净现金流量同比下降 90.88%，主要是上年发行可转债所致。

## 6、主要财务指标

### (1) 偿债能力指标

资产负债率为 39.28%，流动比率为 1.26，速动比率为 1.00；2013 年资产负债率为 44.56%，流动比率为 1.89，速动比率为 1.52。公司的总体财务状况良好，偿债能力较强。

### (2) 营运能力指标

应收账款周转率为 7.14 次，存货周转率为 8.37 次；2013 年应收账款周转率为 6.24 次，存货周转率为 8.18 次。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日